

## 外壳温度的测定

### 目 录

页

#### 1. Econo IPM

600V 系列（封装：P622）芯片配置 ..... 2

#### 2. Econo IPM

1200V 系列（封装：P622）芯片配置 ..... 6

3. 外壳温度的测定..... 10

#### 4. R-IPM 系列（封装：P619）

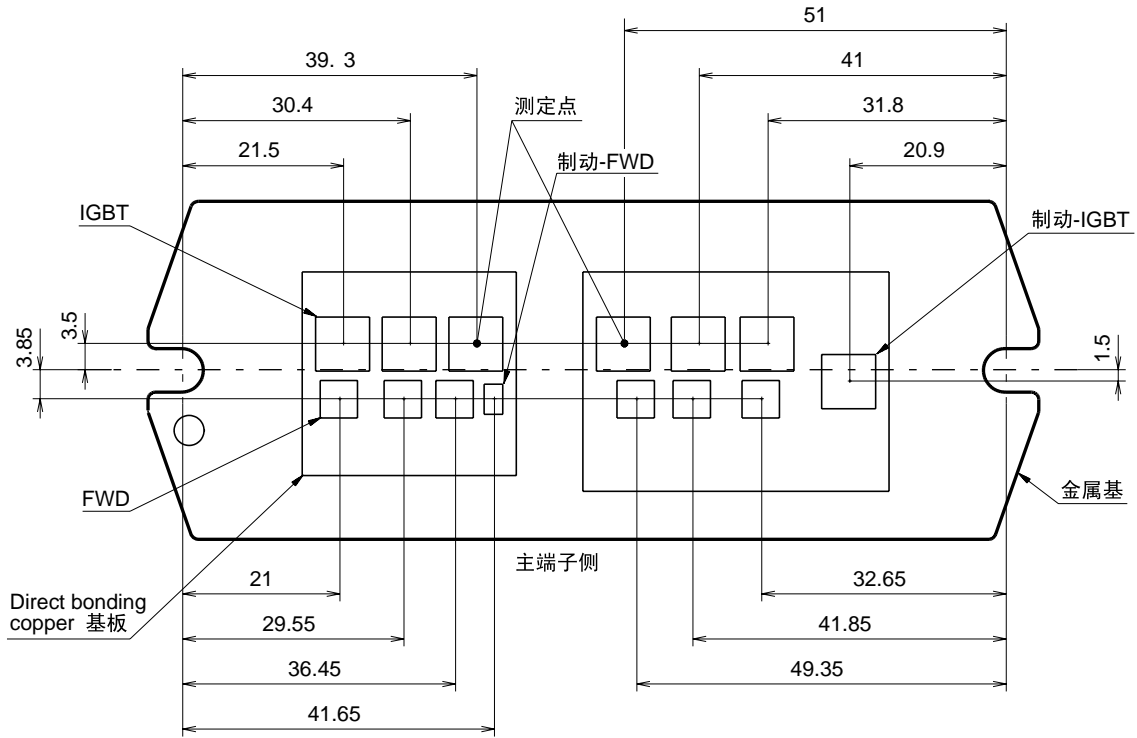
芯片配置..... 12



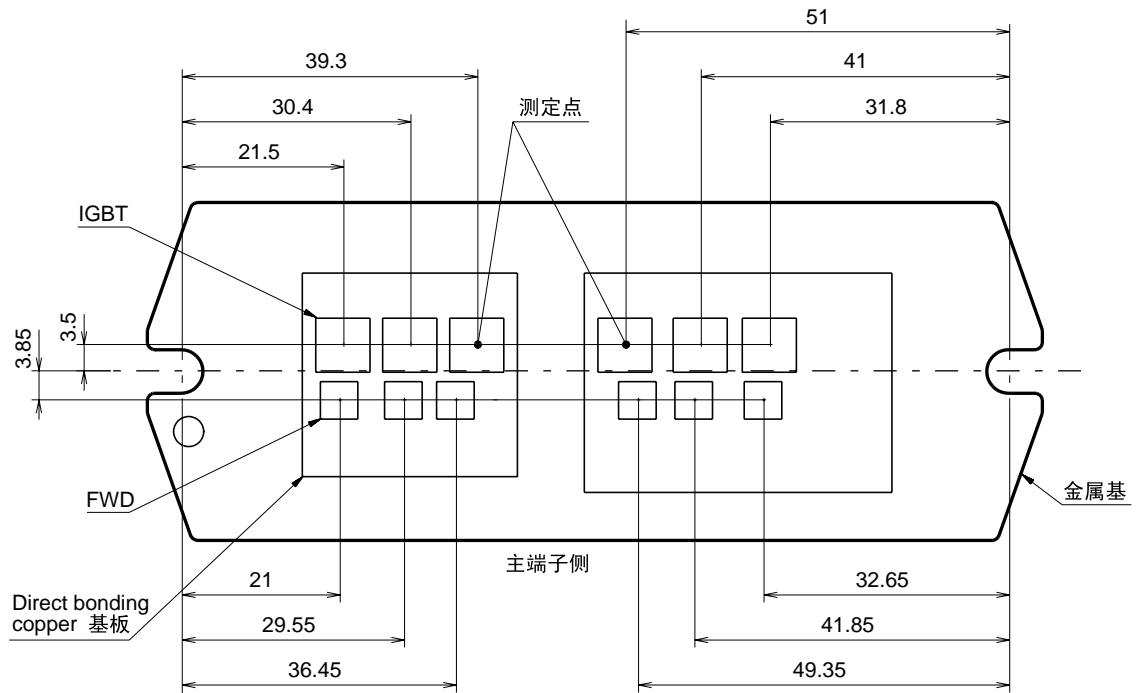


### 1.3 600V/75A

#### 7 in one 封装



#### 6 in one 封装



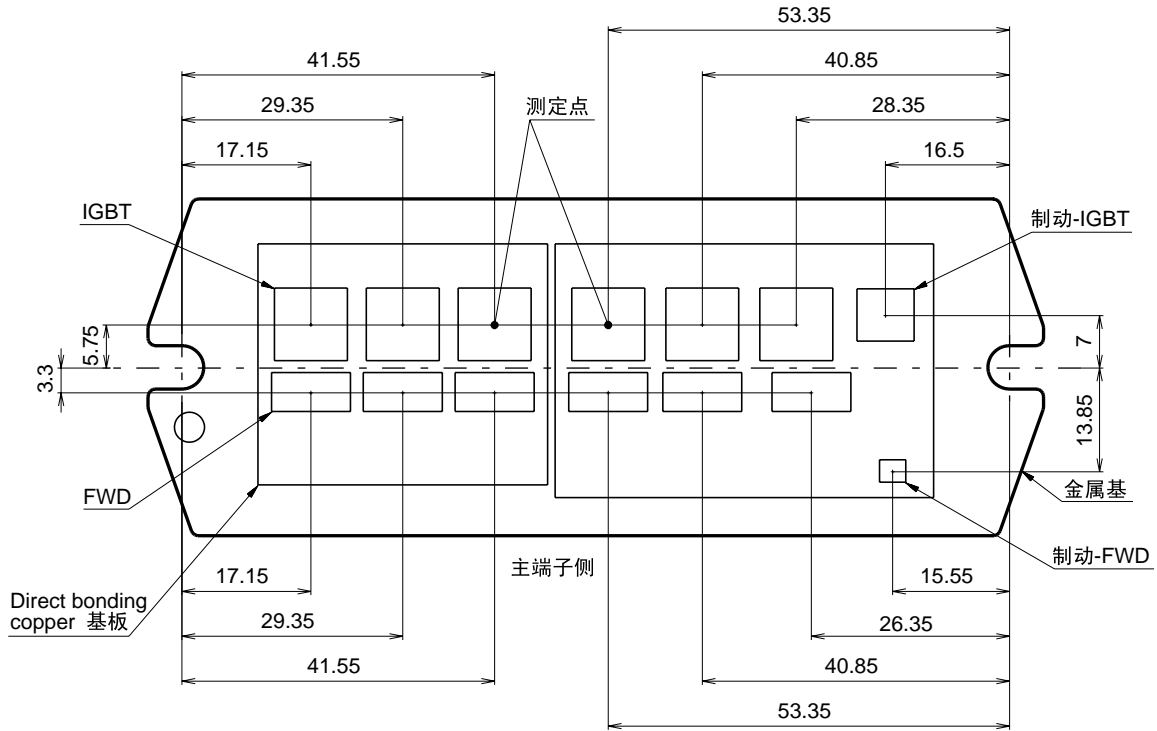


## 2 Econo IPM 1200V 系列（封装：P622）

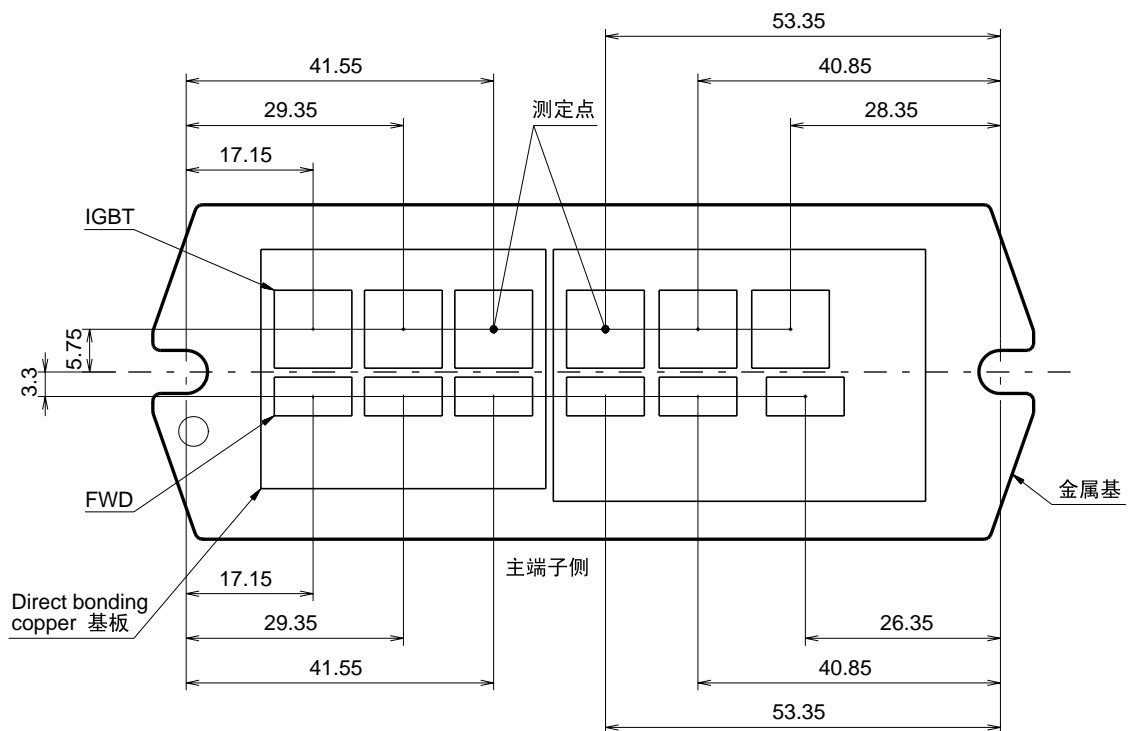
芯片配置 尺寸是 mm

### 2.1 1200V/75A

#### 7 in one 封装

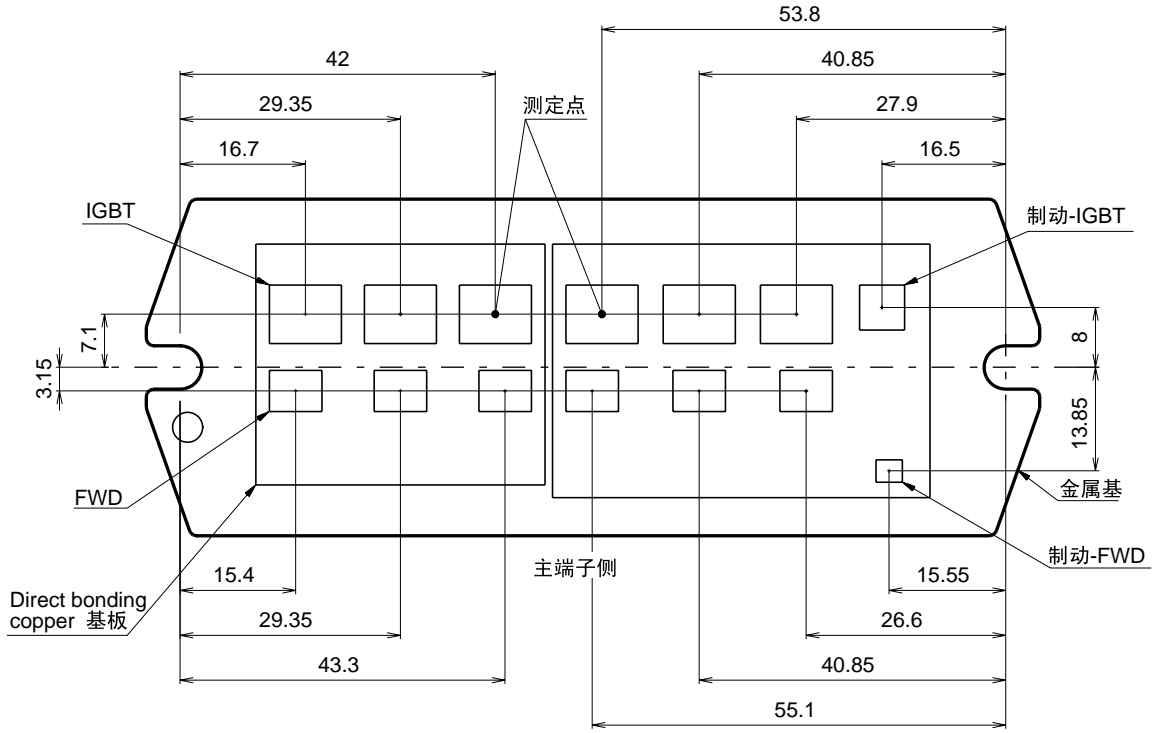


#### 6 in one 封装

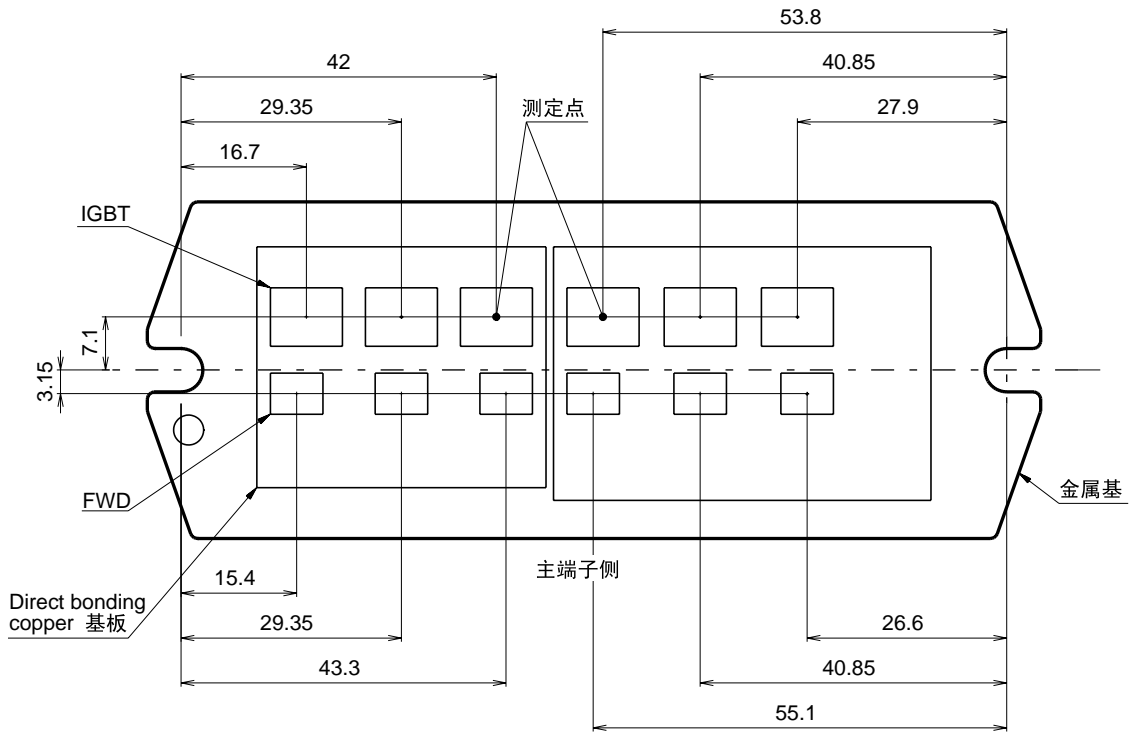


2.2 1200V/50A

7 in one 封装

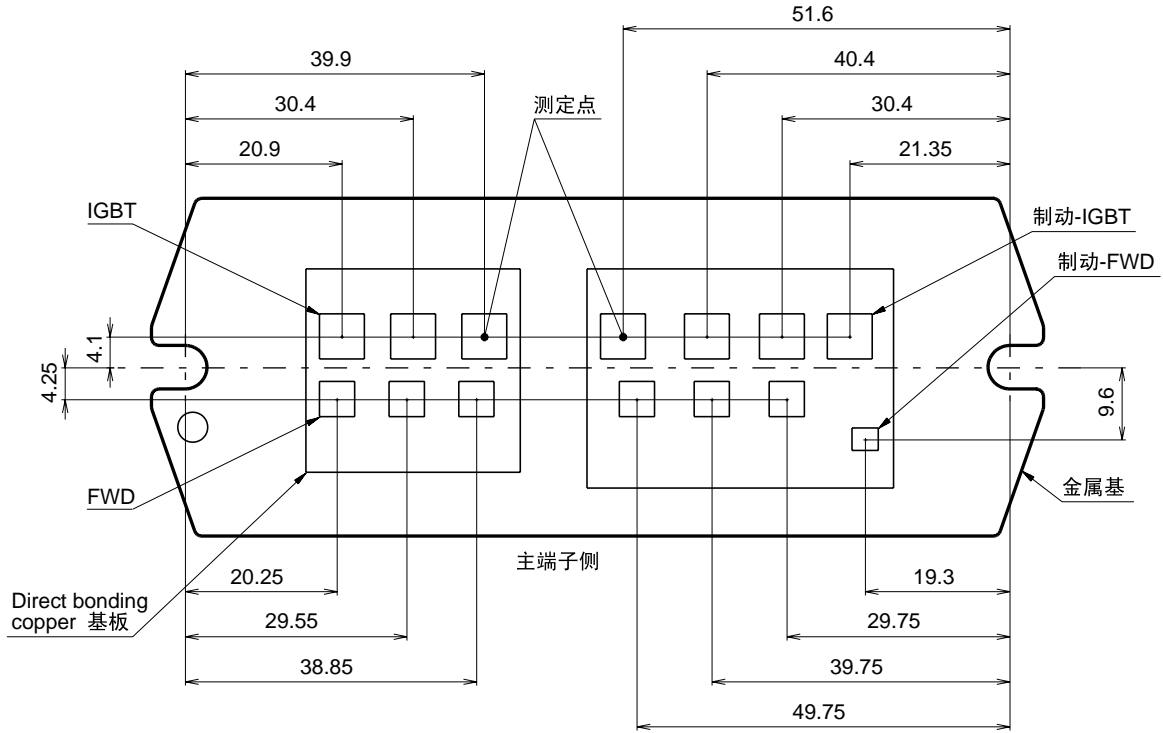


6 in one 封装

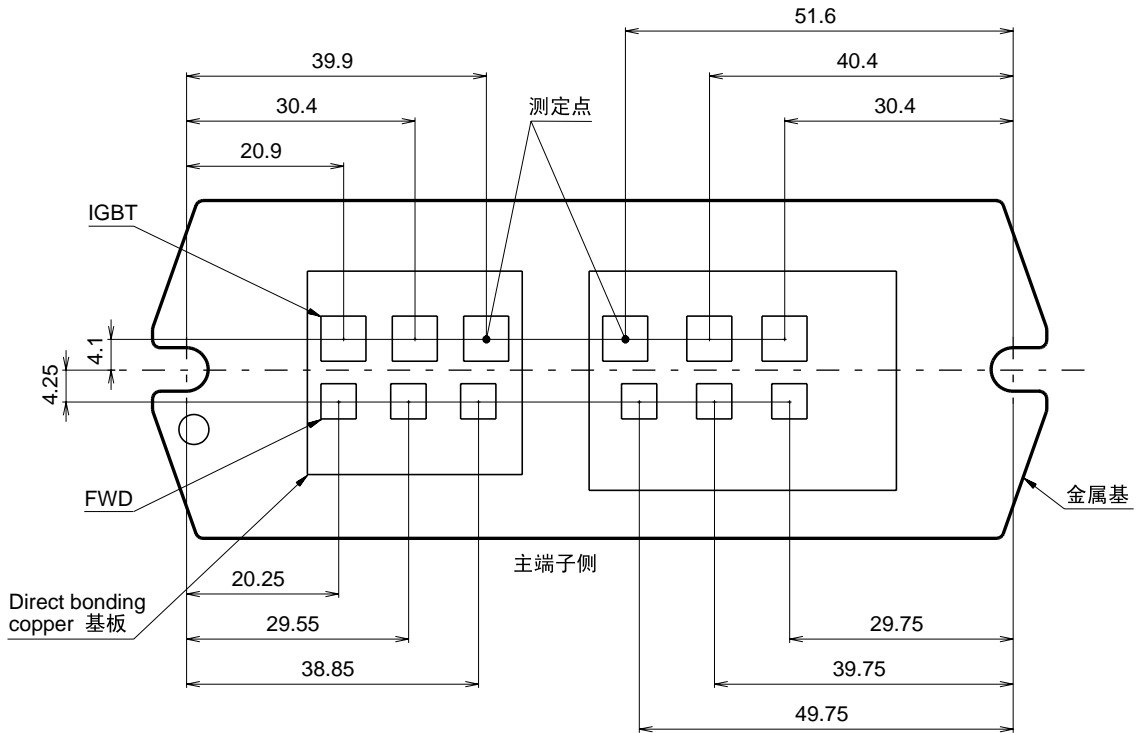


2.3 1200V/25A

7 in one 封装



6 in one 封装

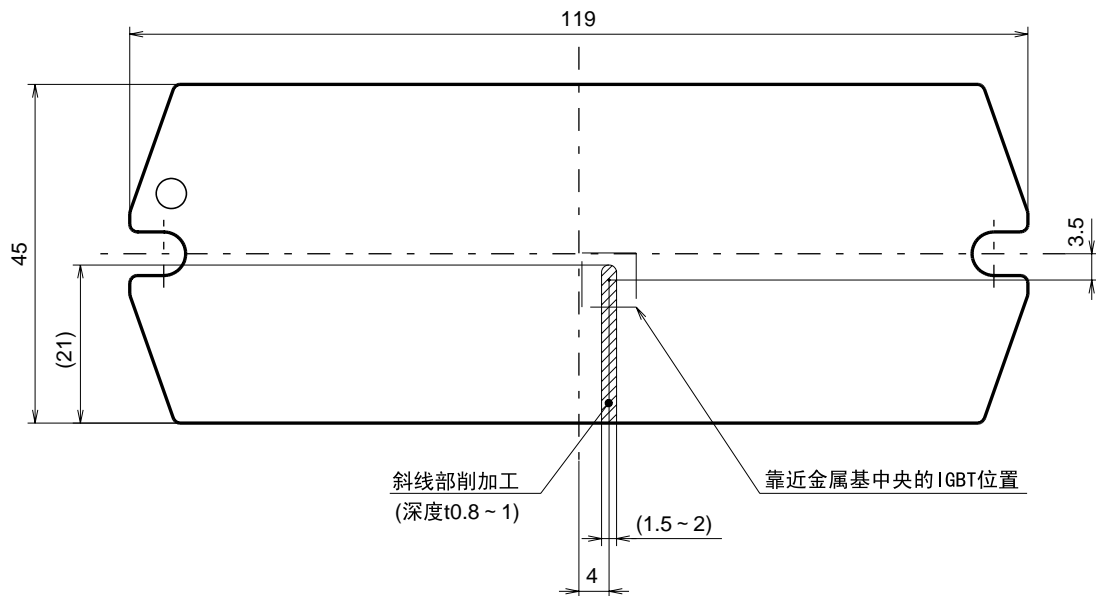


### 3 外壳温度的测定

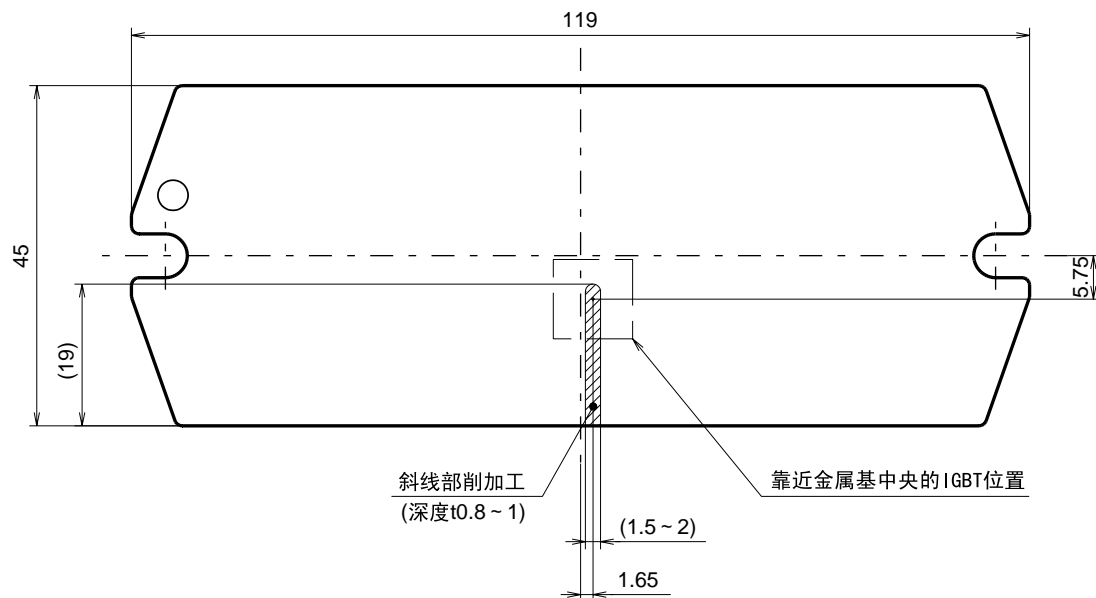
- 请象下图在铜基板后面刻沟。
- 沟的尺寸, 请配合所使用的热电对。
- 请注意如果沟刻得太深, 散热性会变差。
- 请把热电对的异种金属的接合部安装在 IGBT 芯片的直下。
- 用粘着剂把热电对固定, 与沟的间隙用散热绝缘混合剂填埋。

从金属基后面 尺寸是 mm

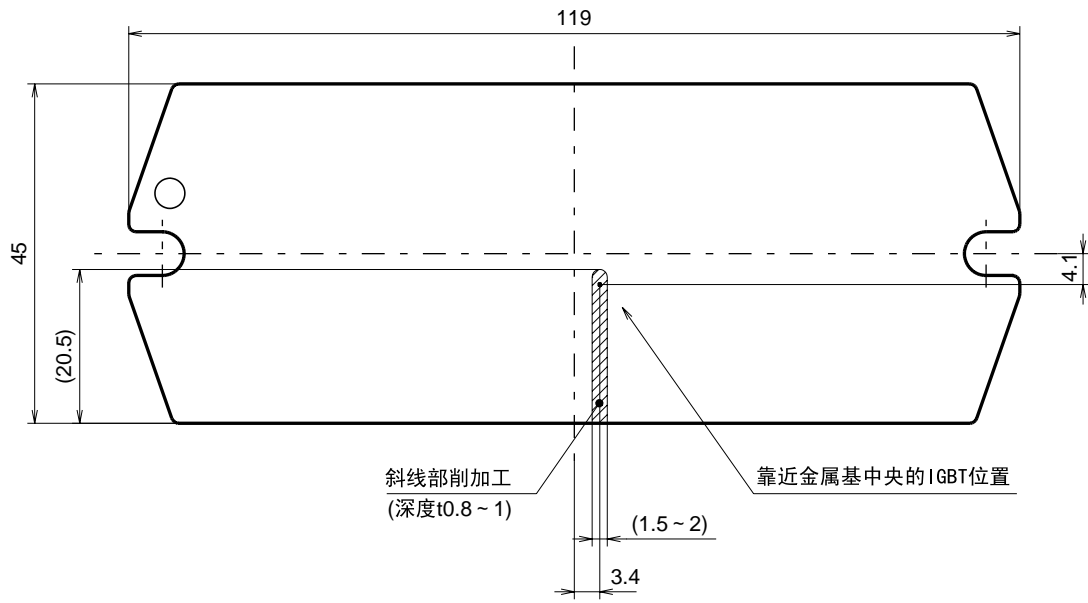
600V/50A、75A: 从金属基后面看时



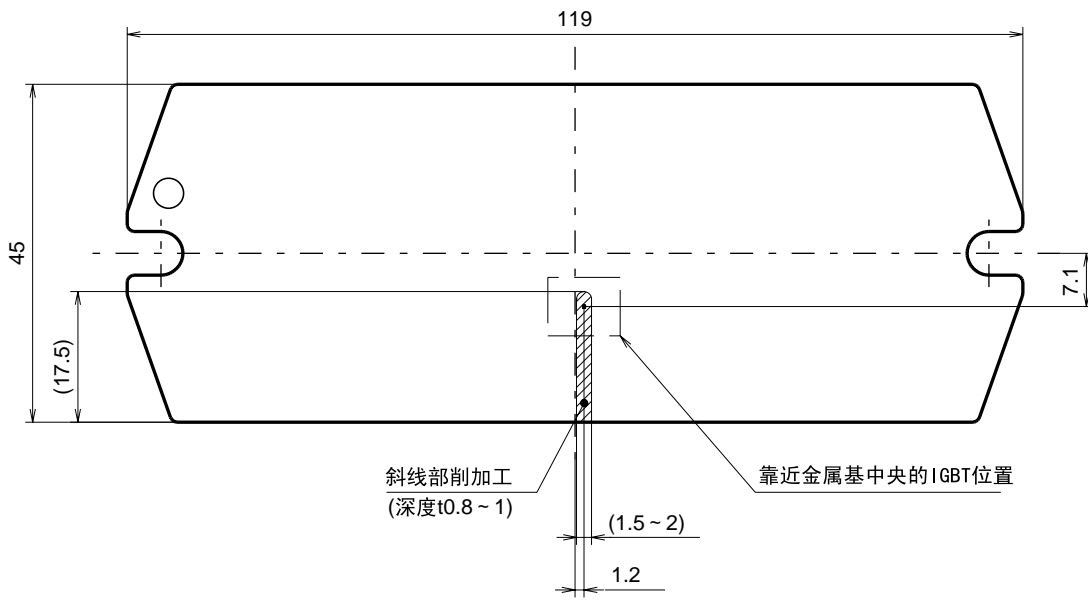
600V/100A、150A、1200V/75A: 从金属基后面看时



1200V/25A: 从金属基后面看时



1200V/50A: 从金属基后面看时



## 4 R-IPM 系列

芯片配置 尺寸是 mm

### 4.1 600V/20A (封装: P619)

